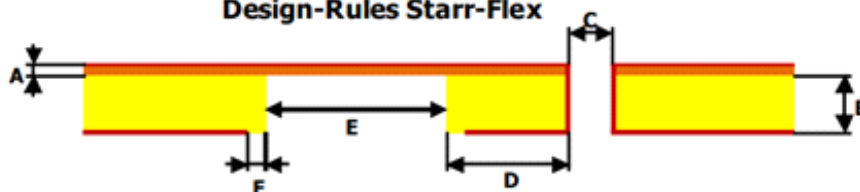


Datenblatt Herstellung Leiterplatten, Starrflex

Basismaterialien	Standard FR4 / Polyimid	
	min. Materialstärke	0,5 mm
	max. Materialstärke	3,2 mm
	min. End-Kupfer-Dicke	35 µm
	max. End-Kupfer-Dicke	70 µm
	T _g	130/150/170 °C
	Flexmaterial aus Polyimid	
Layout	Strukturbreite	125 µm
	Strukturabstand	125 µm
	uml. Löstopplack-Freistellung	50 µm
	kleinster Löstopplack-Steg	150 µm
	kleinste Restringe	125 µm
	kleinste Bohrung (Via)	0,2 µm
	kleinster Fräsradius	250 µm
	kleinster Ritzwinkel	30 °
	Durchkontaktierung	> 20 µm
	Kantenmetallisierung	möglich
Oberfläche	HAL bleifrei / HAL SnPb	
	chem. Ni/Au / chem. Zinn / chem. Ag	
	Hartgold, Bondgold	
	Carbondruck	
Löstopplack	weiß / grün / schwarz / blau / rot ...	
	Durchsteigerfüller	
	abziehbare Lötdeckmaske	
	Kaptonband, hitzebeständig bis 260°C	
Kennzeichendruck	weiß / gelb / schwarz ...	
Qualitätskontrolle	optische Kontrolle	
	AOI	
	elektrischer Test	
	Erstmusterprüfung	
Daten	vorzugsweise Gerberdaten, Eagle, TARGET, PROTEL, Altium, etc.	
Zertifikate / Normen	ISO 9001:2015	
	IPC-A-600	
andere Materialien und Ausführungen auf Anfrage		

Design-Rules Starr-Flex



A	Dicke Polyimid	50 µm
B	Dicke starrer Teil	abhängig von gewünschter Enddicke
C	kleinste Bohrung	0,3 mm
D	Abstand Bohrung zu Flex-Teil	mind. 1,0 mm
E	Breite Flex-Teil	mind. 3,0 mm
F	Abstand Kupfer zu Flex-Teil	mind. 0,5 mm